(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-323052

(43)公開日 平成11年(1999)11月26日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FI				
C08L 27/16		C 0 8 L 27/16				
C08J 5/18	CEW	C 0 8 J 5/18 C E W				
C 0 8 K 5/42		C 0 8 K 5/42				
G 0 2 B 6/00	3 8 6	G 0 2 B 6/00 3 8 6				
G 0 3 G 15/02	1 0 1	G 0 3 G 15/02 1 0 1				
		審査請求 未請求 請求項の数20 OL (全 13 頁)				
(21)出願番号	特顯平11-63378	(71)出顧人 000001100				
		呉羽化学工業株式会社				
(22)出顧日	平成11年(1999) 3月10日	東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番11号				
		(72)発明者 北村 秀樹				
(31)優先権主張番号	特願平10-82748	茨城県新治郡玉里村上玉里18-13 呉羽化				
(32)優先日	平10(1998) 3月12日	学工業株式会社樹脂加工技術センター内				
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 松永 悟				
		茨城県新治郡玉里村上玉里18-13 呉羽化				
		学工業株式会社樹脂加工技術センター内				
		(72)発明者 寺本 嘉吉				
		茨城県新治郡玉里村上玉里18-13 呉羽化				
		学工業株式会社樹脂加工技術センター内				
		于工業体践芸性関加工技術とファード				

(54) 【発明の名称】 ポリフッ化ビニリデン系樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 10°~10°Ωcmの範囲で所望の体積抵抗率を安定して均一に精度よく発揮することができ、環境湿度変化による体積抵抗率と表面抵抗率の変化が小さいポリフッ化ビニリデン系樹脂組成物を提供すること。また、高い光線透過率と低い嚢価を有する透明性に優れたポリフッ化ビニリデン系樹脂組成物を提供すること。さらに、このような半導電性及び、または透明性に優れた樹脂組成物を用いて、各種成形物を提供すること。【解决手段】 ポリファ化ビニリデン系樹脂100重量

【解决手段】 ポリフッ化ビニリデン系樹脂100重量 部に対して、アルキル四級アンモニウム硫酸塩及びアル キル四級アンモニウム亜硫酸塩からなる群より選ばれる 少な とも一種の化合物を0.03~10重量部の割合 で含有するボリフッ化ビニリデン系樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリコ /化ビニリデン系樹脂(A)10 ○重量部に対して、式(1)

【fi: 1 】

$$\begin{bmatrix} R^{1} \\ I \\ R^{2}-N-R^{4} \\ I \\ R^{3} \end{bmatrix} R^{5}SO_{4}$$
 (1)

(武中、R1~R1は、互いに同一または相異なるアル キル基であり、Rid、アルキル基、フルオロアルキル 基。または水素原子である)で表されるアルキル四級ア シモニウム硫酸塩(B1)、及び式(2)

[4:2]

$$\begin{bmatrix} R^6 \\ I \\ R^7 - N - R^9 \end{bmatrix} R^{10}SO_3$$
 (2)

(武中 R'~R'は、互いに同一または相異なるアル キル基であり、RPは、アルキル基、フルオロアルキル。 基、または水素原子である) て表されるアルキル四級ア シモニウム亜硫酸塩 (B2) からなる群より選ばれる少 な」とも一種の化合物(B)をロニロ3~10重量部の 割合で含有するポリノン化ビニリテン系樹脂組成物。

【請求項2】 ポリコッ化ヒニリデン系樹脂(A)が、*

$$R_{\alpha} - D_{\alpha} / (D_{\alpha} + D_{\beta})$$

で定義される吸え度比R a がり~0.8 の範囲内である 請求項1記載のボリコッ化ビニリテン芸樹脂組成物。

【請求項10】 示差走査熱量計を使用して、昇温開始 30 温度30℃、昇温速度10℃。分の条件で測定した際 に、185~200°Cの温度範囲内に小なくとも1つの 吸熱ビークを示す詩末項1記載の樹脂組成物。

【語水項11】 電子写真装置または静電記録装置の帯 電部村に用いられる樹脂材料である請は項1記載の樹脂 組成物。

【請求項12】 請求項1乃至11のいずれか1項に記 載のポリニッ化ヒニリデン系樹脂組成物からなる成形 物。

【請沈項13】 コート、ファイバー、または射出成形。40 物である請求項12記載の成形物。

- 荷電制御部村である請求項12記載の 【請求項14】 戊升:物。

【請述項 1.5】 荷電制御部村か、電子写真装置または 静電記録装置における半導電性部材である請求項14記 載の成形物。

【請求項16】 平導電性部村が、ヤンヴ溶1.0GP aリ上のバルト状またはシーリ状部材である請求項15 記載け成形物。

* ファ化ヒニリデンのホモポリマーである請求項1記載の 樹脂組成物

【請表項3】 ポリソラ化ビニリデン系樹脂(A)が、 1.4化にエリデンと他の共重合可能なモノマーとの共軍 合体である請求項1記載の樹脂組成物。

【請求項1】「ソッ化ビニリデン共軍合体が、マッ化ビ ニキサフルかはプロピレン共軍合体、アマ化 ゼニリテン テトラフルナロエチレン共重合体、または ファ化じニリデン・ゲトラブルオロエチレン 一ペキサブ ルオロプロピリン共軍合体である請求項3記載の樹脂組 成物、

【請求項5】 アルキル四級アンモニウム硫酸塩(B 1) か、アルキル四級アンモニウム硫酸水素塩である請 **水項1記載の樹脂組成物。**

【請求項6】 アルキル判級アニモニウム硫酸水素塩 が、ゲトラブチルアンモニウムハイドロゲンサルフェー 上である請求項5記載の樹脂組成物。

【請求項7】 優価かりの%以下である請求項1割載の 樹脂組成物。

【請求項8】 - 体積抵抗率が10゚~10°Ωcmの範 **期内である請求項1記載の樹脂組成物**。

【請求項9】 - 531cm における赤外線吸収スニケ トルの販売度をDaとし、511cm における赤外線 吸収スペップトルの吸光度をDヨとしたとき、式(1)

[数1]

(I)

※1 系樹脂組成物が5.形成された表面層を有するロール状 部村である請求項1.4記載の成形物。

【請求項18】 荷電制御部材が、電子部品包装材、壁 紙、OA機器外装材、帯電防止の間仕切り、または粉体 変装柱の搬送チューフである請求項11記載の成形物。

【請求項19】 元学部村である請求項12記載の成産

【請求項20】 「光学部材か、モファイバー、光ファイ アーの鞘成分。光学しいス、窓ガラス、窓ガラス保護 材、ディスプレイ保護材、CRT保護材、大陽電池の透 光材または照明のカ/いてある請求項19記載の成形: 44

【発明の辯細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ポリファ化にニリ テン系樹脂組成物に関し、さらに詳しては、半導電性及 で、または透明性が要求される分野に好適に使用するこ とかてきるボリジュ化しニリテン系樹脂組成物に関す る。本発明の樹脂組成物は、半遵軍性を活かして、例え ば 電子写真方式の画像形成装置における帯電ロール。 載なロール、画像ロール、帯電 ルー、附電ベルーなど の荷電制御部村(半導電性部村)の少な とも表面層を 【請求項17】 半導電性部村が、ポリファ化ビニリテ※50 用成する樹脂材料として好適である。また、本発明の樹

脂組成物は、制電性、帯電防止性、塵埃吸養防止性などを活かした用途、例えば、電子部品包装材(例えば、コイルム、段、存器)、壁紙、〇A機器外装材、帯電防止の間仕切りなどの荷電制御部材として好適である。

【0002】 公発明において、主導電性の樹脂組成物とは、体積抵抗率が絶縁体と金属導体との中間に位置する 樹脂付料を意味し、より具体的に、10~~10¹⁸Ω c m程度の体積抵抗率を有する樹脂組成物を意味する。体 発明の樹脂組成物は、透明性(高い光轉透過率と低い嚢 価)を括かした用金として、光ファイハーやレンズ。大 10 時電池の透光材、照明のカバーなどの光学部材用の樹脂 材料として好適に使用される。本発明の樹脂組成物は、 手導電性と透明性の両方の特性を括かして、塊機投資的 止性の窓ガラスやディスプレイの保護材などの光学部材 にも好適に使用される。

[0003]

【逆来の技術】電気・電子機器の分野において、半導電性材料として、体積抵抗率が精密に制御された樹脂材料が求められている。例えば、電子写真方式の復写機ペパテクシミリ、レーザービームプリンターなどの画像形成 20 装置(電子写真複写機、静電記録装置など)においては、帯電、露光、現像、転写、定着、除電の各工程を経て画像が形成されている。これら各工程で使用される各種部村を形成するには、体積抵抗率を精密に制御された樹脂材料が必要である。

【0001】このような画像形成装置に装着されている 帯電ロールまたはベルト、転写ロールまたはベルト、現 像ロール、トナー層厚規制プレートなどには、少なごと 4.その表面層が半導電性であること、具体的には、10 「~10°Qcmの範囲内の所望の体積抵抗率を有する」 ことが要求されている。例えば、帯電ロールまたは、ル 上を用いた帯電方式では、電圧を印加した構電ロールは たは、いしを感光体トラムに接触させて、感光体ドラム 表面に直接電荷を与え、一様から均一に帯電させてい。 5。現像ロールを用いた現像方式では、現像ロールと下 ナー供給ロールとの間の爆擦力により、トナーを現像ロ **いルの表面に帯電北部で吸着させ、これをトナー層厚規** 制プレーデで助一にならした後、感光体ドラム表面の静 電潜像に対して電気吸引力により飛翔させて現像してい る。転写ロールまたは、ルトを用いる転写方式では、転 40 写ロールまたは、ルリにトナーと逆極性の電圧を印加し て電界を発生させ、評電界によって生ぜる電子吸引力に よって極力体上のトナーを動写相上に転写させている。

【0005】したかいて、画像形成装置における書電は ールや、ルーなどの荷電制御部村には、適度の範囲の低い体積抵抗率を有することが要求される。また、その体 積抵抗率は、均ってあることが必要であり、場所的に体 積抵抗率が異なると、高品質の画像を得ることができない。例とば、帯電ロールまたは、ルーの体積抵抗率が均ってなければ、感光体表面を一様から均っに帯電させる 50 ことのできず、画像の品質が低下する。さらに、これらの部材には、湿度の変化によって、体積抵抗率や表面抵抗率があまり変化しないことが望まれる。 通常の使用環境上での配度変化によって、荷電制御部材の体積抵抗率や表面抵抗率が大幅に変化すると、安定して高品質の画像を得ることができない。

4

【0006】また。樹脂材料から形成されている〇A機器の外装材や部品などは。奥摩や上ナーなどを吸引すると、外観を損ねたり、故障の原因となる。電子工業における半導体で、イスやLODなどの製造工程で使用される樹脂製の装置や部品、上CやLSIなどの電子部品を包装するためのフィルムや袋、容器は、静電気の発生により埋体を吸着すると、電子部品の品質を損なる。そのため、これらの用金、特にその去層材に使用される樹脂材料には、10~10°Qcm程度の体積抵抗率を付与して、荷電制御性を持たせることが火められている。

【0007】従来、ポリツッ化ビニリデン系樹脂やその成形品の電気抵抗(体積抵抗率)をデげる方法としては、(1) 樹脂成形品の表面に有機系帯電防止剤を輸布する方法、(2) 樹脂に有機系帯電防止剤を練り込む方法、(3) 樹脂にカーボンブラッドや金属粉などの尊電性フィラーを練り込む方法、及び(1) 樹脂にイオン電解質を練り込む方法が知られている。

【0 0 0 8】しかしなから、(1)カガ仏は、ポリノノ 化ヒニリテン系樹脂が非粘着性に優れているため、成形 品表面を拭いたり、洗浄したりすることによって、帯電 防止剤が容易に脱落してしまう。 (2) の方法では、有 機系帯電防止剤として、界面活性剤や親水性樹脂を用い ている。界面活性剤を用いる方法では、成形品表面がら 30 | 界面活性剤をフリートアウトさせることにより帯電防止 性を付与する機構を採用しているため、温度や湿度など の環境の変化によって、体積抵抗率や帯電防止性が大き 。要化する。また、プリペッ化にニリテン系樹脂の長所 である而特殊性が損なわれる。親本性樹脂を用いる方法。 では、所望の帯電防止効果を得るには、親す性樹脂を多 量に配合する必要があるため、ポリノッ化ビニリテン系。 樹脂な来の動汚染性、耐候性、耐壮プン性、耐容剤性な との物性が低下し、しかも、体積抵抗率や帯電防止性の 湿度依存性が大きいという問題がある。動汚染性や衝容 剤性は、電子写真方式の画像形成装置に配置される部材 において、とサーが付着した際に、それをグリーニング (中の場合に)状められる性質でもある。コロナ放電装置な とを装着した画像形成装置は、十八年を発生するので、 而けて:性は部材に求められら性質である。耐候性は、 屋外で使用される看板や窓ガラスの表面保護材として使 用される場合に求められる性質である。

【0009】前記(3)の方法は、多二の分野で採用されている。例えば、帯電コールは、樹脂に導電性/子サーを种り込んた半導電性樹脂組成物を混金上に被覆して用成されている。しかしなから、樹脂中に導電性フィサ

ーを分散させた半導電性樹脂組成物は、一般に、体積抵 抗れの分布が極めて不均一で、そのばらつきは、多一の 場合、数桁に上るものであり、美用性能上問題があっ た。特にポリファ化ビニリデン系樹脂は、表面エネルギ 一か小さいため、薄電性フェラーを分散させた場合、高 電圧の印加などによって導電性フィラーが樹脂中を移動 し、その結果、体積抵抗率が変動してしまうという問題 かあった。しかも、薄電性フィラーを分散させたポリフ >化ビニリデン系樹脂組成物は、一般に耐電圧が充分で はなり、高電圧を繰り返し形加する用金には必ずしも適。10。 さない。また、導電性フィラーを用いて必要とされる半 海電性の水準を達成するには、その充填量を多しする必 要があり、そのため、ポリコッ化ビニリテン系樹脂組成 物の成形加工性や機械的強度が低工したり、あるいは硬 度が高くなりすぎたりするという問題が生じる。 さら に、尊電性フィラーを分散させたポリフッ化ビエリデン 手樹脂組成物は、尊電性カーポンプラッツなどの尊電性 ツィラーによって着色していることが多いため、例え ば、OA機器の外装材や壁紙などの用金に適用するには べ適当である。

【ロロ1ロ】前記(4)のイオン電解質を練り込む方法 は、ポリファ化ビニリデン (PVDF) かイオンの良葬 体であることが占くから知られていること(例でば、特 開昭51 32330号公報、特開昭51 11065 8号公報、特開昭51 111337号公報、特開昭5 1 127872号公報)が込みて、ポリファ化ビニリ テン系樹脂に半導電性を付与するのに有功な方法である。 ことが期待される。ところか、電解質として代表的な塩 孔りチウムや塩化カリウムなどの無機金属塩をポリフィ 化ビニリデン系樹脂に練りせんた樹脂組成物は、これら 30 の無機金属塩が当該樹脂に僅かしか溶解しないため、体 精抵抗すを1~10°Ωcm以下にするのは困難であっ た。また、過剰に抵加した無機金属塩の膨集物がフィッ シュアイの原因になるなどの問題があった。この凝集物 をボリノ、化ビニリデン系樹脂に存解させるために、混 練温度を上げたり、混練時間を長くしたりすると、樹脂 及び、または電解質か分解して、実質的な機械物性や外 観を損なう。さらに、Li塩のような樹解性のある金属 塩の場合。樹脂に多量に充填すると、樹脂組成物が吸湿 性を持つようになるため、湿度の変化によって体積抵抗。 率が大きて変化したり、プリードアウトした金属塩の潮 解物により成形品の表面が (たっこという問題が生し

【0011】匍解質の樹脂に対すら経解性を向しさせる ための方法として、特開昭60~177061号公報及 つ特開昭61 72061号公報には、プロヒレンカー ボネイトなどの極性特別を樹脂に含ませる方法が提案さ むている。しかし、この与法では、樹脂のY。?

学の著 し、低工したり、プリートアウトした電解質と結剤によ って樹脂才面がべたったなどの問題があった。

h 【0012】従来より、四級アンモニウム塩を樹脂の帯 電防止剤として使用する方法が提案されている。例え ば、特開昭 16 6 1 9 8 9 5 公報には、四級アンコニ ウム塩と樹脂とを有機溶剤に溶解した帯電防止コーティ 2/7村が開示されている。しかし、このコーディング村 は、冼舟によって脱落し易く、長期間の帯電四上的果を 持続せるのは困難である。特開昭 17 3835号公報 には、四級アンモニウム塩をポリナレフィンに練り込ん だ掛電防止性1 -- 上が開示されている。しかしながら、 この帯電防止性、一下は、四級アンモニウム塩が樹脂が らプリートアウトすることによって帯電防止効果を発揮 する機構であるため、温度や湿度などの環境変化によっ で、その導電性と帯電防止効果が大き「変化してしま」 う。しかは、ポリオレフィンのような極性の小さい樹脂 中では、電解質がイオン化し難いために、表面抵抗する 下げることは下きても、体積抵抗率は上げることができ

成形品に発泡や着色などの不具合が生ぜる。 【0013】また、多~の金属塩や四級アンモニウム塩 は、特に高程度環境下でプリートアウトし場で、例で ば、半導体デバイスの製造工程において、制電性包装材 表面の金属不純物が製品の干良化の原因になったり、電 子写真方式の画像形成装置に装着される転送ロールペー ルトにおいては、樹脂中の電解質の減少によって表面層 の体積抵抗値が変化し、画質が低工してしまうなと問題

なかった。さらに、ほどんどの四級アンモニウム塩、特 にいロゲン化四級アンモニウム塩は、熱安定性におった

め、ポリファ化ビニリデン系樹脂(この樹脂の加工温度 は、220~270°C程度である)と溶融混合すると、

【0014】光学科学科に関して、近年、オプトエレット ロニクス分野では、軽くて加工性に優れた樹脂透明材料 か強しもめられている。しかし、光学用途に使える透明 樹脂材料は、ポリマモルメダクリレート、ポリカーエネ ート、ポリスチレン、脂肪族環状構造を有するような一 部のオレフィン樹脂などに限られていた。ところか。こ のような従来の樹脂を、例えば、コンパフトディスクや 元磁気学 イスクのビックアップレンスに用いると、ポリ メチルメダクリレーし、ポリスチレン、ポリカーホオー 上のような吸湿し易い樹脂は、吸湿による守佐変化や帰 折率の変化がよるスの表面がら進行するため。レンツ金 体の特性が不助しになる。そして、それによって、いっ サー光の波面が割れ、書き足み読み取りの両方に悪影響 を及ぼすという問題があった。また、自動車に搭載する コミッキケトウェアのブリントヤのピュッケー・プレンスに は、100~130℃、あらいはそカリーの耐熱性が要 求されるが、ポリノチルメククリレバーしては、その要求 を満足させることは難しかった。

【0015】さらに、プロシェクションテレビやカメラ などの一般の光学新では、1枚のレングでは、どうして も元の彼長によって焦点距離差が出る色収差が生じてし

まうため、屈折率とアッド数の異なる複数の材料を組み合わせて、色収差を解消する。色消し、という設計が必要となる。ガラフレンフでは、屈折率とアッド数の異なるガラフは200種類は上に及ぶため、色消し設計は比較的容易であるが、プラスチッドレンスだけを使用した場合には、前記のように使用できる透明樹脂材料は数種類しかないとに、冷樹脂材料の屈折率が1、5~1、6付近に集中しているため、色消し設計が非常に難して、この分野では、新規な透明樹脂材料が落によめられていた。

【0016】元プァイトーには、石英ガラスや多成分ガラスを訂(コア)成分や鞘(ユラット)成分とするカラマ系元プァイトーのほかに、岩成分及び鞘成分をとれにプラスチッツが正升成したプラスチッツ元プァイトーが知られている。プラフチック系元プァイバーは、ガラス系元プァイバーと比較して、製造及び取り扱いが容易で、変価であるが、その一方で、耐久性と耐熱性にあり、伝送損失が大きいという欠点を持っていた。

【0017】 ポリア・化ビニリテン(PVDF)は、耐熱性及び耐候性に優和、吸湿が少なく、屈折率が1、12程度で他の透明樹脂と比較して小さいことがら、アラフチック系元ファイハーの鞘成分として明符されている。しかし、PVDFは、加工成年の際、結晶化によって自濁し場いため、例えば、特問昭63 22872号公報、特開平1 97901号公報、特開平5 60931号公報、特開平8 106019号公報などでは、アフリル樹脂とアレントして透明化する方法が提案されている。ところが、PVDFとアフリル樹脂をブレントすることにより、PVDFの特徴である耐熱性、耐候性、非吸湿性が低下し、屈折率もアフリル樹脂に近付いてしまうなどの欠点があった。さらに、樹脂とうしのフレント系は、光学的に平均一になり場下、光散制が大きいという問題がある。

【0018】 ポリソー化ビニリテン等樹脂は、優れた耐候性を活かして、事務用品、看板、建築材料などの装面保護材として使用されているが、窓ガラスやCRTの保護ファルムとして使用するには、透明性に干濁があった。

【0019】ポリン・化ミニリテン系材脂の透明性を向上させる方法としては、産来より、KCIやNaCIな 40との無機塩を結晶柱剤として使用する方法や、実質的に決延伸のシート状または主更成形物を 帝延伸または高温高圧条件ドで延伸する方法が提案されている。しかし、無機塩を発促する方法は、耐寒物がフェッシンでの原因になるなどの問題があった。実質的に大延伸の、一上状または主サ成形物を、冷延伸または高温高圧条件下で延伸する方法は、脱大な加工設備が必要であり、生産性に問題があった。また、どちらの方法を、透明性の改善効果は不充分であった。

[0020]

【発明分解決しようとする課題】本発明の目的は、10°~10°Ωcmの範囲で所望の体積抵抗率を安定して 均一に精度よ「発揮することができー環境最度を化による体積抵抗率と表面抵抗率の変化が小さいポリファ化ビニリデン系樹脂組成物を提供することにある。

8

【0021】また、本発明の目的は、高い光緯透過率と低い鏤価を有する透明性に優れたポリファ化にエリデン系樹脂組成物を提供することにある。さらに、本発明の目的は、このような半導電性及び、または透明性に優わた樹脂組成物を用いて、チューブ、シート、ファイニー、射出成形物などの半導電性及びごまたは透明性の各種成形物を提供することにある。

【0022】本発明者らは、前記従来技術の問題点を完 服するために鋭意研究した結果、ポリファ化もエリテン 系樹脂に、アルキル四級アンモニウムの硫酸塩または亜 硫酸塩を特定の割合で発加した樹脂組成物が、透明性に 優れるとともに、半導電性領域の体積抵抗率を有し、場 所による体積抵抗率のパラツキがなし、しかも所望の体 積抵抗率を安定して精度良し発揮することができること を見いだした。また、この樹脂組成物は、凝集物やフィ ッシュアイの生成かなり、添加剤のブリートアウトもな い。さらに、この樹脂組成物は、加工性が良好であり、 一般の容融加工法により種々の成五品に成五するに できる。本発明は、これらの知見に基づいて完成するに

[0023]

至ったものである。

【課題を解決するための手段】本発明によれば、ポリフー化ビニリテン系樹脂 (A) 100重量部に対して、式(1)

[0024]

【化3】

$$\begin{bmatrix} R^1 \\ I \\ R^2 - N - R^4 \end{bmatrix} R^5 SO_4$$
 (1)

【0.02.5】 (式中、 $R^1 \sim R^1$ は、互いに同一または 相異なるアルキル基であり、 R^2 は、アルキル基、フル コロアルキル基、または水素原子である)で表されるア ルキル四級アンモニウム硫酸塩(B.1)、及び式(2)

【化 1】

[0026]

$$\begin{bmatrix} R^6 \\ \downarrow \\ R^7 - N - R^9 \\ \downarrow \\ R^8 \end{bmatrix} R^{:0}SO_3$$
 (2)

【0 0 2 7 】(式中、 $R^6 \sim R^8$ は、互いに同一または相異なるアルキル基であり、 R^8 は、アルキル基 フルオロアルキル基、または水素原子である)で表されるア ルキル四級アニモニウム亜硫酸塩(R 2)からなる群よ

り選ばれる小な とも一種の化合物(B)を0、03~ 10 重量部の割合で含有するポリア) 化ビニリデン系樹 脂組成物が提供される。また、本発明によれば、眩ボリ 7) 信じニリデン等樹脂組成物からなる成形物が提供さ 1050

[0028]

【課題を解析するための手段】ボリニー化ビニリテン系

な発明で使用するボリ / →付ビニリデン系樹脂 (A) と しては、ソン化ビニリデンのボモガリマー(すなわり、 ポリコー化ビニリテン(PVDF)、及びフラ化ビニリ デンを主構成単位とするファ化ビニリデンと他の共重合 可能なモノマーとの共重合体を挙げることができる。ツ 小化ビニリテンの重合体としては、「一化ビニリテン。 - いキサフルオロプロピレン共和合体、ファ化ヒニリテン テトラフルけびエチいい地重合体、プラ化ビニリテい ゲトランルオロエチレン・ペキサンルオロプロりょう |地重合体が好適なものとして至けられる。また、これら ポリプル化ビニリデン系樹脂は、それぞれ単独で、ある いは2種類以上を組み合わせて使用することができる。

【0029】ポリツッ化にエリテン系樹脂の中でも。耐 活染性、耐力プン性、耐溶剤性の観点がらは、ファ化モ ニリテンのボモボリマーであるPVDFが好ましい。楽 軟性や引き裂き強度の観点からは、二十化ビニリディを 主構成単位とする?? っ化ビニリデン共重合体を単独で、 あるいはPVDFとプロコーして使用することが好まし い。接着性を向上させらには、官能基を導入したツァ化 モニリテン共重合体が好適に使用される。ポリア・化ビ ニリデン系樹脂は、アプリル樹脂や他のブッ毒樹脂など 囲内でプレンドして用いてもよい。

【0030】アルキル四級アンモニウムの硫酸塩及び亜

本範囲で使用するアルギル四級でしてニウム硫酸塩(B 1) は、式(1)

[0031]

【生5】

$$\begin{bmatrix} R^1 \\ I \\ R^2 - N - R^4 \\ I \\ R^3 \end{bmatrix} R^5 SO_4 \tag{1}$$

【0032】 (込中、R1~R1は、互いに同一または 相異なるアルキル基であり、Rfは、アルキル基、フル オロアルキル基、または土素原子である) て表される化 合物である。本発明で使用するアルキル四級アンモニウ ム亜硫酸塩(B2)は、式(2)

[0033]

【化6】

$$\begin{bmatrix} R^8 \\ I \\ R^7 - N - R^8 \\ R^8 \end{bmatrix} R^{10} SO_3$$
 (2)

Ju)

【0031】 (式中、R'~R'は、互いに同一または 相異なるアルキル基であり、Rioは、アルキル基、フル オロアルキル基。または火素原子である)で表される化 合物である。これらの化合物の中でも、安定性に優れる ことがら、アルキル四級アンモニウム硫酸塩 (B1) が 10 好ましい。

【0035】これらか化合物(B)において、R ~R * またはR* トR* におけるアルキル基の段素数の合計 は、通常4以上であるが、好ましては8~30。より好 まし、は12~21、特に好まし、は15~20であ る。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロビ 4基、イノブロビル基、プチル基、ペンチル基、・キュ 4.基などの短鎖アルキル基を例示することができる。R 及びR[®]がアルキル基である場合には、メチル基やエ チル基などの短鎖アルキル基が代表的なものである。R 20 * 及び R " が 7 ル 十ロアルキル 基である場合には、 C F 、C下、などの短鎖アルオロアルキル基が代表的な。 れのてある。

【0036】これらの化合物 (B) の具体例として、例 $\mathfrak{K}(\mathbf{f}, -(\mathbf{C}, \mathbf{H}), \mathbf{N}), -(\mathbf{C}, \mathbf{H}), \mathbf{N}), -(\mathbf{C}, \mathbf{H})$, - (C.H.) A 等のアルキル四級アンモニウム カチオンと、CF3SO4、CH3SO4、HSO4、C F₂SO₂、CH₃SO₂、HSO₂などの硫酸または亜 硫酸を含むアニオンとからなる塩を挙げることができ る。これらの化合物(B)は、2種類以上のアニオン及 の平の他の熱可塑性樹脂を、本発射の目的を妨けない範。30 ひカチナンを組み合わせた塩であってもよい、また、四 粉で、モニウムが有する1つのアルギル基は、それぞれ 同一であっても異なっていてもよい。これらの中です。 アルキル回殺アンモニウムの硫酸水素塩が好ました。ゲ トラブチルアンモニウム・イトロゲンサルフィート

> (C:H) :NHSO。 か特に好ましい。 これらの化 合物は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わ せて使用することがてきる。

【0037】ポリノー化ビニリテン系樹脂は、通常、他 の物質と単に溶融混合しただけではる型構造を呈する か、アルキル四級アンモニウムの硫酸塩または再硫酸塩 **季加すると、容融混合の過程で、ポリアッ化ビニリデン** 系材脂が食型構造になる。このことから、これらの化合 物は、ポリアの化ビニリアに新樹脂に対して、予型結晶 **柿剤として作用していると考えられる。**

【0038】ポリニー在ビニリテン系樹脂組成物 |本発明のポリアン化ビニリサン|新樹脂組成物は、ポリン >化ビニリテン系樹脂(A)と前記信合物(B)とを含 有すら樹脂組成物である。化合物(B)の配合割合は、 ポリファ化ヒニリテン系樹脂(A)100重量部に対し 一て、0.03~10重量部の範囲内であって、好まし。

12

は $0.05 \sim 8$ 重量部、より好ましては $0.1 \sim 5$ 重量部、特に好ましては $0.3 \sim 2$ 重量部である。この配合割合が過小であると、化合物(B)の添加による改善的果が小さり、過去であると、樹脂の着色や加工時の分解発泡を生しることがある。なお、化合物(B)の好ましい配合割合は、要求される物性によって、適宜定めることができる。

【0039】特開平8~99374号公報空特開平7~ 28266号公報に示されているように、電子写真式復 **身機やレーサービーム式プリンターなどにおいて使用さ 10** れる転等ペルトは、強性 私の高いものが好ましい。 具体 的には、ハルトのヤング科がT. OGP a IJ 上であるこ とが好ました。 I、 5 GP a 以上であることが特に好ま しい「ヒころが」前記化合物(B)の孫加量が多しなる と、樹脂組成物から形成された。一手のヤンで至か極端 に低下する傾向を示す。したかって、このような樹脂組 成物を電子写真方式の画像形成装置の帯電ーエーに使用 すると、経時により帯電ニルトが伸びてしまい、転写工 程で画像スレが発生するという問題がある。本発明のば、 リコッ化にニリデニ系樹脂組成物を、電子写真式復写機 20 やレーザーモーム式プリングーなどにおいて転写、ルト として使用する場合には、ポリフッ化ヒニリデン系樹脂 (A) 100重量部に対する前記化合物(B)の配合割 合は、ローロ3~5重量部か好ました。ロー1~3重量 部がより好ました。0.3~2重量部が更に好ました。 ロ、5~1 重量部が特に好ましい。

【0010】本発明のポリツ・化ビニリデン系樹脂組成物を透明性が要求される分野で使用する場合、より具体的に、例えば、事務用品、OA機器、建築材料、看板の表面保護材料として使用する場合には、前記式(1)で 30定義される吸光度比Radi、0、8以下が好まして、0、5以下が特に好まして、カ、本発明の樹脂組成物を光学レンスや光ツァインで、光学フィルタなどに使用する場合には、Radi、0、5以下が好まして、0、3以下がより好まして、0、1以下がさらに好まして、0、05以下が特に好まして、Radi、所望により、0、02以下にすることが可能である。

【0011】吸光度は、ボリファ化ヒニリデン系材脂 (A)の単量体組成、化合物(B)の種類。化合物 40 (B)の添加量、延伸加工の有無などによって変化する。したかって、吸光度比の調節は、ナリファ化ヒニリデン系材脂(A)水化合物(B)の種類の選択、化合物(B)の添加量の調整、延伸加工条件の調整。これらの組み合わせにより、好適に行うことができる。例えば、国はに示されるように、化合物(B)の添加量を増加させれば、吸光度比が低下する。また、後記の表施例11~12に示されるように、例えば、ボリファ化ビニリデン系材脂組成物の、一十至延伸すれば、吸光度比を著して小さですることができる。化合物(B)の森加量の調 50 整と延伸処理を組み合わせてもよい。 吸光度圧の F限 は、D α がぜつの場合、 0 となる。

【0012】他の孫卯物

料発明のポリファ化ビニリデン系樹脂組成物を透明性分 野使用する場合には、他の振加剤をできる限り含有させ ないことが望ましいが、薄電性分野で使用する場合に は、所望により他の添加物を含有させることができる。 他の孫卯物としては、例えば、タルク、マイカ。」リ カ、アルミナ、カオリン、フィライト、チダ、酸カリウ ム、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、水酸化マクネンウ ム、貨酸カル、ウム、貨酸ニッケル、硫酸カル、ウム。 硫酸パリウム、水酸化デルミニウム、ガラス粉、石英粉 村、黒鉛、無機顔料、有機金属塩、他の酸化金属などの 松牞または粉封近フィラー:原素繊維、ガラス繊維、ア スペスト繊維、プリカ繊維、アルミナ繊維、ブルコボブ 繊維、睾化ホウ素繊維、睾化ケイ素繊維、ホウ素繊維、 チタン酸カリ繊維などの繊維状 フィラー・などが挙げる わる。これらのフィコーは、本発明の目的を阻害しない。 範囲内で、使用目的に応じて適宜配合することができ 5.

【0043】また、ブリツァ化ビニリデン系統指組成物 には、例立ば、酸化防止剤、潜剤、可塑剤、有機節料、 無機顔料、紫外線吸収剤、界面活性剤、無機酸、有機 酸、p日調整剤、架橋剤、カップリニン剤などの乱用の 添加剤を、体発明の効果を阻害しない範囲内で、適宜配 含することができる。

【0011】樹脂組成物の調製法、成形法、及び用途 本発明のポリツッ化ビニリテン系材脂組成物の調製法に は、特に制限がなり、好適な方法としては、例えば、① ポリソッ化ビニリテン系樹脂の粉末または・レットと、 前記化合物(B)とをミキサーなどの混合機で混合する 方法、②音成分を混合機で混合した後、混合物を溶融押 出し法によって、レット化する方法、②各成分を水また は水と水溶性溶剤との混合溶剤に溶解ないしは分散さ せ、ミキサーなどの混合機で混合した後、乾燥し、得ら れた乾燥物を溶融押出して、レット化する方法などが発 けられる。

【0015】 体発期のボリア、化ビエリラン 系樹脂組成物は、アレス成形法、溶離抑制法、射出成形法、溶極流 40 無法、変布法などの各種成形法により、各種成形品や被覆成形品に成形加工することができる。また。ボリア・化ビニリテ、系樹脂(A)に行合物(B)を高濃度で含有させたでスタース、デを作成しておき、成川時に必要に応した化合物(B)の濃度になるように、砂樹脂で看釈してから成形加工することもできる。

【0046】本発明のボリアン化ビニリザン等 樹脂組成物をシースレス・ルーに押出成刑する場合は、連絡溶融押出成刑ななが好まして用いられる。シームレス・ルトの望ましい連総溶融押出成刑法としては、1軸スクリュー押出機とスパイラル環サケイスを用いて、ダイスのリン

プから直下に押出し、内部冷却マナトレル方式によって 内径を制御しなから引き取る方法等があげられる。 料発 明のポリソッ化ビニリデン系樹脂組成物を用いてレート 有製造する場合、連続押出成产法として、1軸または2 軸スクリュー押出機とエダイスとを用い、容融対態の診 樹脂組成物をリップから直下に押出し、冷却上ラム上に エアーナイフなどにより密着させつの治却固化する方法 を挙げることができる。 な発明のポリ たっ化ビニリデン 系樹脂組成物を溶融状態が引調化させるには、冷却温度 た。30~100℃の範囲内に制御することが好まし 、ロー3 0 Cの範囲内に制御することが特に好まし

【0017】 な発明のポリ 1、化ヒニリデン系 樹脂組成 物は、電子部品包装用の静電気防止フィルム、静電気防 止容器、各種OA機器に使用される専収着防止部材、除 |電部杆、導電部杆、1003、光学フィルター、透明フェ ルム、透明容器などに好適に用いられる。本発明のはり 2 小化ビニリデン系樹脂組成物の成形方法は、特に制限 されるものではなり、射出成形や溶融押出法などの公知 の成形が法により、例えば、デートリやファイトーはに 成形加工することが可能である。加工後、さらに、延伸 や勢固定することも可能である。 本発明のポリコラ化ビ ニリテ、系樹脂組成物は、それ単独で使用してもよう また、必要に応して他の樹脂層などと複合化させて、積 層シートや複合系にして使用してもよい。

[0048]

【実施例】口上に、実施例及び比較例を挙けて、な発明 についてより具体的に説明する。物性の測定法は、次の とおりてある。

(1) 厚灰棚泥

成形物の具みは、タイヤルゲー、厚み計(小野側器社 製、商品名 DG 911) て測定した。

(2) 体積抵抗率

本発明において、体積抵抗率か10°Qcm以上の試料 は、リング状電極を有するレントディビディセル(商品 名。HP16008F、ヒューレットパラカート社製。 内側の電極の直径2.6、0mm、外側の電極の内径3。 8. 0mm、外側電極の外径 10. 0mm) に荷重 7 k とでせまでがら挟み、内側電極と対向電極との間に14。 抗チャーを抵抗測定器(商品名)ハイレシスタンスメー グロ111-1339A、ビューレットパーカート社製)でお がけ、このようなリンツ電極なによる体積抵抗率制定法。 び詳細は、JIS K6911を参照することができ る。を毎期において、体積抵抗率が10°Ωcm主流へ 試わは、リンク状プロープ(商品名:HRSプローフ、

菱化学社製、内側の電極の直径5.9mm 外側の電 極の内径11、0mm、外側電極の外径17、8mm) と制定(テージ(簡品名 い。テーブルFILL 菱化学 礼集)との間に試料を抖み、約3kg重の圧力で押さえ。50。で24時間調湿した後、測定した。

14

つけつつ、プロープの内側電極と測定ステーミとの間に 500 Vの電圧を印加して、抵抗 名測定装置(商品名: ハイレスターP。三菱化学社製)で体積抵抗率 a、を求 めた。このようなり、『電極法による体積抵抗率側定法 の詳細は、JIS-K6911を参照することができ Z) ,

【0019】 (3) 平均値の算出

上記した厚みと体積抵抗率の測定は、これらの値を測定 すべき試料の表面積1m 当たり任意に選んたこり点の。 測定点、もしては任意に選んだ20個の成形物について 1個に付き1点(計20点)測定し、その最大値、最小 値、平均値 (算術学場) を求めた。

(1) ヤンで紅

J 1 8 - K 7 1 1 3 に準拠し、幅 1 0 m m 、長さ 1 0 0 mmの短冊型試験片を用い、引張試験機(TENSIL ON RTM100型、オリエンテラク社製)により引 張連度50mm~分、チャック間距離50mmの条件で 測定した。

【ロロ50】(5)体積抵抗率の湿度依存性

本発明において、リング状電極を有するいによっていた イセル(商品名:HP 1 6 0 0 8 B、ヒューレットパッ カート社製、内側の電極の直径とも、Omm、外側の電 極の内径38.0mm、外側電極の外径10.0mm) に荷重でkgでサンプルを挟み、所定の温度と湿度に調 節された恒温恒湿槽(商品名 1.日30 13M ナガ 7科学機械製作所社製)中で2.1時間放置した後、内側 電極と対向電極との間に100Vの電圧を1分間(原み 方向に) 印加したときの体情抵抗率力、を抵抗測定器 (商品名) ハイレジスタンスメータHP1339A、ヒ 30 ユーレット・・カート社製) て求めた。このようなリン **芝電桶法による体積抵抗率制定法の詳細は、118-K** 6911を参照することがてきる。体積抵抗率は、相対 湿度30%、50%、70%、及び90%の順に脊湿度 環境で24時間調湿した後、測定した。

【0051】 (6) 表面抵抗率の湿度依存性

|本発明において、リング状電極を有するレジックテビア マセル (商品名 HP16008B、ヒューレットアー カーナ社製、内側の電極の直径2.6、 0 mm、外側の電 極の内径3.8 0mm、外側電極の外径10.0mm) Vの電圧を1分間(厚み方向に)印加したときの体積抵 40 に荷重7kgでサンプルを挟み、所定の温度と環度に調 節された恒温恒湿槽()商品名。1.日30 1.3 M、ナガ **()科学機械製作所社製)中で21時間放置した後、内側** 電極と外側電極との間に101の電圧を1分間(表面方 向に) 印加したときの表面抵抗率が。を抵抗測定器(商 品名 ラゼル・スクンフィーグHP4339A、カルー レッドパーカー [社製] て出めた。このようなリング電 極法による表面抵抗率測定法で詳細は、JIS K69 1.1を香磨することができる。碁面抵抗をは、田対湿度 30%、50%、70%、及む90%の順に各福度環境

【0052】(7) 曇価(HAZE)

曇価は、「イブメータ (商品名: Σ80、日本電色工業 社製)を用いて測定した。曇価の測定方法の注細は、J IS K7015を登開することができる。

(8) 赤外線吸収スペットル (IR)

赤外線吸収ス (2 F いは、1 ーリエ変換赤外分元光度計 (商品名 | F T T R | 8 2 0 0 。島津製作所社製)、全 反射側定セル (商品名 | A T R | 8 0 0 0 。島津製作所 社製) 、及むプリズム (K R S | 5 、島津製作所社製) *

$$R_{\alpha} = D_{\alpha} / (D_{\alpha} + D_{\beta})$$

【0054】ただし、x c m における赤外線吸収スペ ニトルの吸光度D x は、x c m における入射光の強度 10と透過光の強度 1 から式 (1-1) 式より表められ ※

$$D_x = log_{10} (l_0/I)$$

【0056】なお、吸光度を求めるペースラインは、図8のB及びCに立てように、500cm 付近と545cm 付近にある山に接線を引くか、Dβが極めて大きい場合には、そのように接線を引くた、520cm 付近の山に接線が変わるので、図8のAに示すように、545cm 付近の山と520cm 付近の山に接する接線なっ、並びに、520cm 付近の山と500cm 付近の山に接する接線なった引くことにより定め、そして、この一・フラインに基づいて、Da及びDβを求める。

(10) 示差,赴青點量測定 (DSC)

示差走だ熱量測定装置(製品名 * DSC 3 0 、Me t t l e r 往襲)とデータプロセッサ(製品名 * TC 1 0 A、 Me t t l e r 往製)とを用い、下記条件により 30 DSC 法によって測定した。

条件:試料重量10mg、測定開始温度30℃、測定終 丁温度250℃、昇温速度10℃。分

【0057】 実施例1~7、及び比較例2~6 麦1 に示す組成の樹脂粉末及び添加剤を混合機(川田製作所 社製、商品名 フーハーミキサー)に投入して、四転数 1000 r p m 可約5 分間充分に機軽混合した。次い て、得られた混合物を1軸ペクリュー押出機(プラ技研 社製)を用いて、タイツ温度2 10 でで直径約3 m m程 度にペレット化した。このペレットを2 3 0 で てアレス 40 成用直後、20℃で含金して、厚さり、25 m m のシー 上を得た。物性の測定結果を表1に示す。

【0058】 実施例8 表1に示す組成の構脂粉末及で指加剤を用い、アレア成形直接に100℃で行命した 22体は、実施例1~7と同様にして、厚さ0、25mmのハートを得た。物性の測定結果を表1に示す。

【0059】 実施例9及210 妻1に示す組成の樹脂物和及2統加剤を混合機(川田製作所社製、商品名 2一パー・キサー)に技人して、回転数1000rpm で約5分間充分に攪拌混合した。さいて、得られた混合 50 16

* を用いて、ATR法(Attenuated Tota 1 Reflectance)により、100cm か ら1000cm 切範囲で測定した。

(9) 吸光度比尺 a

531cm における赤外縛吸収フークトルの吸光度Daと、511cm における赤外線吸収フークトルの吸光度Daとから式(I)式よりまめた。

[0053]

【数2】

(I)

× 5.

[0055]

【数3】

 (Π)

物を1軸スプリュー押出機(プラ技研社製)を用いて、 ダイス温度240 Cで直径約5 mm程度に ペレット化し た。このようにペレット化した原料を1軸スクリュー押 20 出機(プラ技研社製)を用いて、リップクリアランツ 0.7 mmの工型ダイス(ダイフ温度240 C)に供給 し、ダイスから押出された溶融材脂を90 Cの冷却ロー ルによって、一下に成形した。物性の測定結果を表1に 余字、

【0060】 [接施例11] 実施例10 下得られたい一 上を110℃に関節したテンターでリップ式延伸機によ り、縦方向に3、5倍に延伸し、厚さ35μmの一軸配 向でイエムを得た。このでイエムの改光度上R点は、 0、05であった。物性の測定結果を表1に示す。

【0061】 [実施例12] 実施例10 1 得られた1 一 トを110 でに調節したデンタープリップ式延伸機により、縦切向に3、5 倍に延伸し、さらに横方向に3、5 倍に延伸し、さらに横方向に3、5 倍に延伸して、厚さ10 μ mの「軸配向フィルムを得た。このフィルムの吸光度比R a は 10、0 2 であった。物性の測定結果を表1に示す。

【0062】 (比較例1) PVDF ペレットを230°C でプレス成形した後、20°Cで急合して、厚さり、25 mmのトートを得た。物性の測定結果を表1に示す。

【0.063】 [比較例 7 PVDF、いっトを1軸2 7 リカー押出機(プラ技研社製)を用いて、リップクリアランス0、 7 mmの下型タイス(タイス温度2 1.0 C)に供給し、ダイスから押出された溶融材脂を9.0 Cの冷却の一点によって、一上に成形した。物性の判定結果を表1に示す。

【0064】 上較例85 比較例7で得られたシートを 140℃に関節したデンタープリップ式延伸機により、 縦方向に3、5倍に延伸して、厚さ35µmの一軸側向 フィルムを得た。このフィルムの吸丸度比比αは、0。 97であった。物性の測定結果を表上に示す。

【0065】 [比較例9] 比較例7で得られたシートを

140℃に調節したテンタークリップ式延伸機により、 縦方向に3.5倍に延伸し、さらに、横方向に3.5倍 に延伸して、厚さ10μmの 1軸配向フィルムを得た。 このフィルムの吸光度比Raは、0.59であった。物*

*性の測定結果を表1に示す。

[0066]

【表 1 】

		組 成 (重量部)		体積抵抗率 (Ωcm)			HAZE
		樹脂	添加剂	平均值	最大值	最小值	(%)
	1	PVDF(100)	TBAHS(0.1)	1.3 × 10 ¹¹	1.8 ± 10 ^{tt}	9.7 × 10 ¹⁰	39.9
	2	PVDF(100)	TBAHS(0.3)	3.6 × 10 ¹⁰	4.9 • 100	2.9 × 10 ¹⁰	38.1
	3	PVDF(100)	TBAHS(0.5)	2.9 × 1010	3.2 × 10 ¹⁰	1.4 > 1010	35.8
実	4	PVDF(100)	TBAHS(1.0)	6.3 × 10°	8.8 ^ 10 ^s	4.0 × 10°	49
***	5	PVDF(100)	TBAHS(3.0)	1.8 × 10°	2.4 ^ 10°	1.2 × 10°	2.8
施	6	PVDF(100)	TBARS(5.0)	1.2 > 10°	2.0 × 10°	9.1 × 10°	4.5
A91	7	VDFP(100)	TBAHS(1.0)	1.0 × 10°	1.6 > 10°	8.7 > 10 ⁸	2.0
6 91	8	PVDF(100)	TBAHS(1.0)	1.0 - 1011	2.2 > 10 ^{ct}	7.9 × 10 ¹⁰	10.4
	9	PVDF(100)	TBAHS(0.3)	2.8 × 10 ¹¹	3.5 × 10 ¹¹	1.8 < 10 ¹¹	8.5
	10	PVDF(100)	TBAHS(1.0)	5.3 × 10 ¹⁰	7.0 × 10 ¹⁰	4.3 · 10 ¹⁰	1.3
	11	PVDF(100)	TBAHS(1.0)	1.2 × 10 ¹²	2.7 > 10 ¹²	8.3 × 10 ¹¹	1.0
	12	PVDF(100)	TBAHS(1.0)	2.0×10^{12}	4.1 > 10 ¹²	1.1×10^{12}	0.2
	1	PVDF(100)	_	3.0×10^{14}	4.8 > 1014	2.1 × 1014	46.4
	2	PVDF(100)	TBAHS(15)	8.0 < 10 ⁸	3.5 > 10°	2.6 · 10 ⁸	25.5
比	3	PVDF(100)	TEABr(1.0)	5.4 × 10 ¹²	1.1 × 10 ¹⁸	2.4 × 1012	53.7
	4	PVDF(100)	TBABr(1.0)	2.7 × 10 ¹¹	5.6 × 10°	1.3 × 10 ¹¹	43.1
較	5	PVDF(100)	TEAC1(1.0)	6.8 × 10 ¹²	1.3 × 10 ¹⁸	4.3 × 10 ¹²	59.5
	6	PVDF(100)	MAC1(1.0)	2.2 × 10 ¹²	4.5 × 10 ¹²	1.0 · 1012	58.0
69	7	PVDF(100)	-	2.4 × 10 ¹⁴	4.2 × 10 ⁻⁴	1.8 × 1014	42.6
	8	PVDF(100)	-	5.2 > 10 ¹⁴	77 > 10.4	2.3×10^{14}	4.6
	9	PVDF(100)		8.1 > 1014	2.8×10^{15}	3.7×10^{14}	3.2

【0067】脚注:

- (1) PVDF:ポリフッ化ビニリデン〔呉羽化学工業
- (株) 製、KF#1000]
- (2) VDFP:フッ化ビニリデン 六フッ化プロピレ ン共重合体〔呉羽化学工業(株)製、KF#2300〕
- (3) FBAHS (C₁H₂) NHSO₄(富山薬品工 業(株)製〕
- (4) FEAB r (C₂H₁) ₁NBr 〔和光純要
- (株) 製)
- (5) TBABr [CH (CH:)] NBr 和光 純菓 (株) 製]
- (6) TEAC1 (C₂H₂) ₄NC1 (和光純薬
- (株.) 趣门
- (7) MAC1: CH₂NH₃C1 [和光純薬(株) 製]
- 【0068】表1の結果から明らかなように、本発明の ポリファ化ビニリデン系樹脂組成物 (実施例1~10) は、体積抵抗率が適度に低く、バラソキも少なる、しか も曇価が小さいものである。また、本発明のポリフッ化 50 明らかなように、TBAHSの添加量が大き上なるに従

- ビニリデ: 系樹脂組成物は、配合割合や成形条件を選択 することにより、曇価を著して小さくすることができる。 (実施例4~10)。 さらに、実施例1~10におい て、試料中に凝集物やアイッシュアイは観察されず、赤 加剤のアリードウトも観察されなかった。
- 【0069】これに対して、添加剤がない場合(比較例 1及び7)、化合物(B)の配合割合が大きすきる場合 40 (比較何2)、本発明の化合物(B)以外の添加剤を指 加した場合(比較例3~6)には、いずれも下満足な結 果しか得ることができない。特に比較例2~りでは一〇 レット化の際に樹脂組成物が褐色に着色し、分解発泡し た。したかって、割1に示されている比較例2~6の物 性は、着色発泡、一下についての測定値である。また、 比較例3~6のプレフシートは アンモニア県がした。 【0070】ヤング 転の測定

実施例1~6、及び比較例1T濶製した名サンプルを用 いてヤンデ室を測定した。結果を図りに示す。図1から

って、シートのヤンダギが急激に低下する傾向を示す。 HAZEの測定

実施例1~6、及び比較例1で調製した各サンプルを用いてHAZFを測定した。結果を図2に示す。図2から明らかなように、TBAHSの係加量が大き なると、、ートのHAZEが急激に小さらなり透明性が増す傾向を示す。

Raの測定

実施例 $1 \sim 5$ 、及び比較例 1 で調製した各サンプルを用いてR α を測定した。結果を図 3 に示す。図 3 から明 δ 10 かなように、TBAHSの添加量が大き、なると、 $1 \leftarrow$ 下のR α は色像に小さっなも傾向を示す。

【0071】DSC测定1

実施例2、実施例4、実施例5、及び比較例1 で調製した各サンプルを用いてDSC 側定を行った。結果を図4 に示す。図1から明らかなように、実施例2、実施例4、及び実施例5 かDSC チャートには、185~20 0°Cの範囲に、比較例1には見られないピーツが観察される。

DSC測定2

表施例4及び表施例8で調製した各サンプルを用いてDSCを測定した。結果を図5に示す。図5から明らかなように、プレス成形後に徐冷した実施例8のDSCチャートでは、実施例4で見られる185~200℃の範囲のピークが消失する。

【0072】体積抵抗率の測定

考施例10 「調製したサンブルを用いて、体積抵抗率の 湿度依存性を測定した。結果を図らに示け。図らから明 らかなように、本発明のボリファ化ヒニリデン系樹脂組 成物から得られたシートは、体積抵抗率の湿度依存性が 30 小さい。

表面抵抗率の側定

実施例10 「調製したサンプルを用いて、表面抵抗率の 湿度依存性を測定した。結果を図7 に示す。 図7 から明 らかなように、本発明のボリファ化ビニリデン系材脂組 成物から得られたシートは、表面抵抗率の湿度依存性が 小さい。

[0073]

【発明の効果】本発明によれば、10°~10°Ω e m の範囲内で所望の体積抵抗率を安定して均一に精度より 発揮することができ、環境程度変化による体積抵抗率と 沢面抵抗率の変化が小さいポリット化ビニリデン系樹脂 組成物が提供される。このポリット化ビニリテン系樹脂 組成物を用いて、チュービュート、ファイバー、射出 成形物などの半導電性成析物を得ることができる。ま一* *た、本発明によれば、曇価が低二、透明性に優れるポリファ化ビニリデン系樹脂組成物が提供される。このポリンク化ビニリテン系樹脂組成物を用いて、チューブ、ミート、ファイバー 射出成形物などの透明性成形物を得ることができる。

【ロロティ】本発明のポリノッ化ヒニリデン系樹脂組成 物は、平導電性分野としては、電子写真方式の画像形成 装置における帯電ロール、転写ロール、現像ロール、帯 電コルト、陰電コルトなどの荷電制御部材のデなことも 表面層を形成する材料として好慮である。ロールが部村 としては、芸金上に直接または他の樹脂層及び。または ゴム層を介して、最外層にポリファ化,ピニリテン系樹脂 組成物層が形成されたものが挙げられる。また、本発明 の樹脂組成物は、電子部品包装材(例えば、 / テルム 袋、岩器)、壁紙、OA機器外装材、帯電防止の間仕切 り、粉体症装付の搬送チューブなどの各種荷電制御部村 として好適である。 本発明のポリ 10化ビニリラン 系統 脂組成物は、透明性分野として、光ファイバー、光ファ イント-の鞘成分、元学レンフ、窓カラス、窓カラス保護 - 村、ディスプレイ保護材、CRT保護村、大陽電池の透 元材、照明のカバーなどの光学部材として好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、実施例1~6、及び比較例1 て調製した高サンプルのヤング系を、タイカフチルアンモニウムニストロタンサルフェート(TBAHS)の番加量との関係で示した図である。

【図2】図2は、実施例1~6及な比較例1で調製した 各サンプルの優価をTBAHSの特加量との関係で示し た図である。

【図3】図3は、実施例1~5及む比較例1 T調製した 各サンプルのR α をT B A H S の希加量の関係で示した 図である。

【図4】図44は、実施例2、実施例4、実施例5、及む 比較例1 て調製した各サンバルを用いて、DSC測定を 行った結果を示す図である。

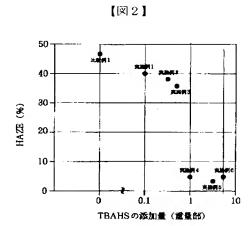
【図5】図5は、実施例1及び実施例8で調製した各サコピルを用いて、DSC測定を行った結果を示す図である。

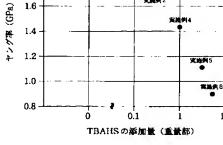
【図6】図6は、実施例10 T調製したサンプルを用い 40 て、体積抵抗率を湿度との関係でおした因である。

【図7】図7は、実施例10 「調製したサミアルを用いて、表面抵抗率を湿度との関係で示した図である。

【図8】図8は、赤外線吸収スペニュールの映光度を求めるペープラインの確定法を示す目である。

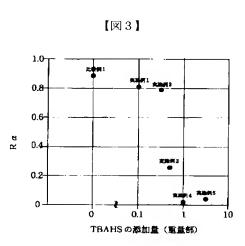


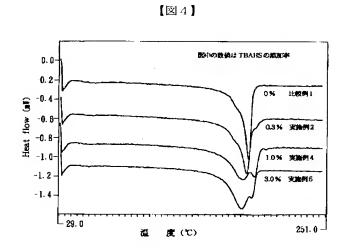


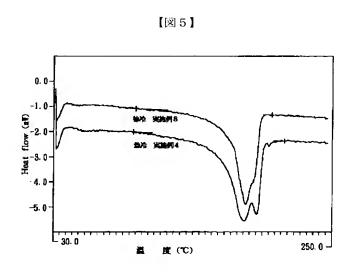


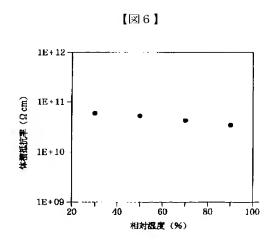
2.0 1.8

1.6

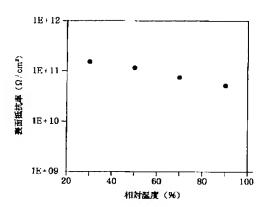








【図7】



[図8]

